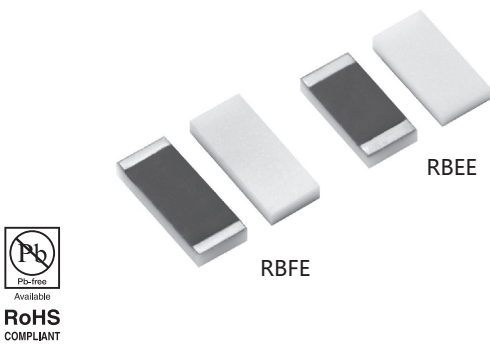


高精密金属箔贴片电阻 (倒装芯片)
宽阻值区间, 最低至 0.5Ω



温度系数, 阻值范围, 精度, 额定功率				
系列号	温度系数 (ppm/°C) -25°C ~ 125°C*	阻值范围 (Ω)	阻值精度 (%)*	额定功率 (W) 70°C
RBEE	0±10 (C)	0.5 ~ 1	±0.5 (D)±1.0 (F)	0.5
	0±25 (J)	1 ~ 100	±0.1 (B)±0.5 (D)	
	0±5 (X) 0±10 (C)	100 ~ 10k	±0.05 (A)±0.1 (B) ±0.5 (D)	
RBFE	0±10 (C)	0.5 ~ 1	±0.5 (D)±1.0 (F)	1
	0±25 (J)	1 ~ 100	±0.1 (B)±0.5 (D)	
	0±5 (X) 0±10 (C)	100 ~ 10k	±0.05 (A)±0.1 (B) ±0.5 (D)	

* 括号内的代码用于选型表

选型表

选型举例：

RBEE C 1R000 B L

编带包装可选
精度
阻值
温飘
系列号

用5位代码表示阻值, 4位代码是有效数字。R或K表示阻值范围 (R代表欧姆, K代表千欧姆) 和小数点的位置。

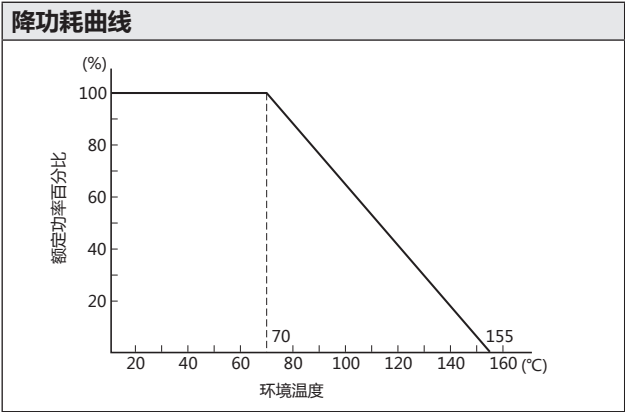
尺寸图

系列	RBEE	RBFE
L	5.0±0.1	6.3±0.1
W	2.5±0.1	3.2±0.1
L ₁	0.4±0.2	0.7±0.2
L ₂	4.0±0.2	4.7±0.2
W ₁	2.3±0.2	3.0±0.2
T	1.05 max.	

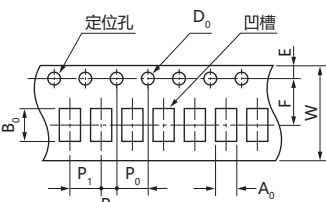
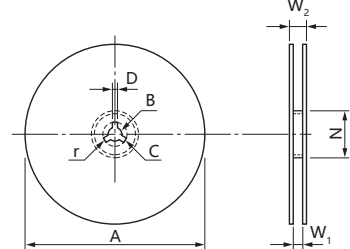
尺寸单位(mm)

结构

- ① 陶瓷基底(高纯度氧化铝)
- ② 耐热粘接层
- ③ 金属箔(Bulk Metal® Foil)
- ④ 金属镀层
- ⑤ 焊接凸点(Sn-Ag-Cu)
- ⑥ 阻焊层

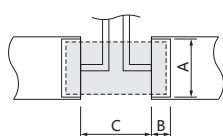


性能参数			
项目	测试条件	ALPHA参数	ALPHA典型测试数据
最大额定工作温度 工作温度范围			70°C -65°C ~ +155°C
热冲击	-65°C/30 min. ↔ +155°C/30 min., 100次循环	±0.1%	±0.03%
过载	额定功率 x 2.5, 5 sec.	±0.1%	±0.03%
低温存储和工作	-65°C, 无负载, 24 hrs. → 额定电压, 45 min.	±0.1%	±0.05%
绝缘电阻 绝缘电阻特性	大气压下: AC 200V, 1 min. DC 100V, 1 min. 260°C, 10 sec.	±0.05% 大于 10,000 MΩ	0.01% 大于 10,000 MΩ ±0.03%
冲击振动, 高频	100G, 6 ms, 锯齿波, X, Y, Z, 各10次循环 20G, 10 Hz ~ 2,000 Hz ~ 10 Hz, 20 min., X, Y, Z, 各2.5 hrs.	±0.1% ±0.1%	±0.01% ±0.01%
耐湿性	+65°C ~ -10°C, 90% RH ~ 98% RH, 额定电压, 10次循环 (240 hrs.)	±0.1%	±0.03%
寿命	70°C, 额定功率, 1.5 hr. - ON, 0.5 hr. - OFF, 1,000 hrs	±0.1%	±0.05%
高温暴露	155°C, 无负载, 1,000 hrs.	±0.1%	±0.05%

编带包装(基于EIA-481-1)																		
编带尺寸  RBEE: 0.30±0.05 RBFE: 0.25±0.05 RBEE: 1.5±0.1 RBFE: 1.2±0.1										包装盘尺寸 								
系列	A ₀	B ₀	W	F	E	P ₁	P ₂	P ₀	D ₀	系列	A	N	B	C	D	W ₁	W ₂	r
RBEE	2.7 ±0.1	5.2 ±0.1	12.0 ±0.2	5.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	Φ1.5 +0.1-0	RBEE	Φ178 ±2	Φ60 min.	Φ13 ±0.5	Φ21 ±0.8	2.0 ±0.5	12.4 +2.0-0	18.4 max.	1.0 ±0.5
RBFE	3.4 ±0.1	6.7 ±0.1	12.0 ±0.2	5.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	Φ1.5 +0.1-0	RBFE								

编带容量 | RBEE: 2,000 pcs/盘 | RBFE: 4,000 pcs/盘

尺寸单位(mm)

使用表面贴装电流检测电阻注意事项	
1. 存储 存储条件或环境可能对电阻引脚的可焊性产生影响。不可存储于高温和高湿环境。建议存储于温度低于40°C, 湿度低于70%RH的环境, 避免接触硫磺气体和含氯气体等。	
2. 焊接注意事项	
① 回流焊接 建议 • 最高温度: 250+0/-5°C • 高温时间: 10 sec. max. • 室温下冷却	
② 浸焊 (波峰或静止) 建议 • 焊接温度: 260°C max. • 浸入时间长: 10 sec.	
③ 其他 推荐无腐蚀焊剂, 比如松脂。焊接后, 不可立即给模压外壳施加应力。	
3. 清洁 使用挥发性清洁剂比如甲醇或者异丙醇。	
4. 电路板设计	
① 推夹ランド寸法 焊盘尺寸 焊接面积取决于电阻尺寸和焊接方法, 也受贴装设备和基板材料的影响, 如右图。	
RBEE, RBFE 	
系列号	尺寸单位(mm)
RBEE	A: 2.5 ~ 2.6, B: 0.6, C: 3.9
RBFE	A: 3.4 ~ 3.6, B: 1.2, C: 4.5